

ICS 31.030
CCS L 90



中华人民共和国国家标准

GB/T 40564—2021

电子封装用环氧塑封料测试方法

Test method of epoxy molding compound for electronic packaging

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般要求	2
4.1 环境条件	2
4.2 样品要求	2
4.3 报告	2
5 外观检测	2
5.1 粉末环氧塑封料	2
5.2 饼料环氧塑封料	2
6 物理和化学性能测试	2
6.1 凝胶化时间	2
6.2 螺旋流动长度	3
6.3 飞边	4
6.4 热硬度	6
6.5 密度	7
6.6 导热系数	7
6.7 黏度	7
6.8 玻璃化转变温度	10
6.9 线性热膨胀系数(TMA 探针法)	14
6.10 吸水率	15
6.11 阻燃性	17
6.12 电导率(萃取水溶液)	17
6.13 pH 值(萃取水溶液)	18
6.14 钠离子含量(萃取水溶液)	19
6.15 氯离子含量、溴离子含量(萃取水溶液)	22
6.16 溴含量、锑含量、氯含量	24
6.17 灰分	25
6.18 铈含量	26
7 机械性能测试	30
7.1 弯曲强度	30
7.2 冲击强度	33
7.3 成型收缩率	33
7.4 粘结强度	34
8 电性能测试	37